

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年11月12日(2009.11.12)

【公開番号】特開2008-187087(P2008-187087A)

【公開日】平成20年8月14日(2008.8.14)

【年通号数】公開・登録公報2008-032

【出願番号】特願2007-20806(P2007-20806)

【国際特許分類】

H 01 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/60 3 1 1 S

【手続補正書】

【提出日】平成21年9月25日(2009.9.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

回路基板上に樹脂テープを貼り付けて樹脂テープの上から電子部品を実装する電子部品実装方法において、

前記樹脂テープを該樹脂テープにおける電子部品の隣接する2つの角に対応する角部分の角度が90°未満の角度になるように切断し、切断後の樹脂テープを前記回路基板上に押圧し、該樹脂テープ上で前記電子部品を押圧することを特徴とする電子部品実装方法。

【請求項2】

前記2つの角が、前記樹脂テープを貼付したベーステープの剥離方向に対して、一定寸法オフセットしていることを特徴とする請求項1記載の電子部品実装方法。

【請求項3】

前記樹脂テープを前記回路基板上に押圧する際に、前記切断後の樹脂テープにおける90°未満の角度の2つの領域における加圧力を、前記2つの領域以外の領域における加圧力よりも大きくすることを特徴とする請求項1または2記載の電子部品実装方法。

【請求項4】

前記樹脂テープを切断する際に、該樹脂テープにおける前記90°未満の角度として切断する2つの領域の切断面と前記樹脂テープの基板貼付面とのなす角度を、前記2つの領域以外の領域の切断面と前記樹脂テープの基板貼付面とのなす角度よりも大きくすることを特徴とする請求項1～3いずれか1項記載の電子部品実装方法。

【請求項5】

回路基板上に樹脂テープを貼り付けるテープ貼付装置において、

前記樹脂テープを供給するテープ供給部と、前記回路基板を保持する保持部と、前記樹脂テープを該樹脂テープにおける前記電子部品の隣接する2つの角に対応する角部分の角度が90°未満の角度になるように切断するカッタと、切断した樹脂テープを前記回路基板に押圧する押圧部とを備えたことを特徴とするテープ貼付装置。

【請求項6】

前記押圧部により、前記切断後の樹脂テープにおける90°未満の角度の2つの領域における加圧力を、前記2つの領域以外の領域における加圧力よりも大きくすることを特徴とする請求項5記載のテープ貼付装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

請求項2に記載の発明は、請求項1記載の電子部品実装方法において、2つの角が、前記樹脂テープを貼付したベーステープの剥離方向に対して、一定寸法オフセットしていることを特徴とする。

請求項3に記載の発明は、請求項1または2記載の電子部品実装方法において、樹脂テープを回路基板上に押圧する際に、切断後の樹脂テープにおける90°未満の角度の2つの領域における加圧力を、2つの領域以外の領域における加圧力よりも大きくすることを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

請求項4に記載の発明は、請求項1～3いずれか1項記載の電子部品実装方法において、樹脂テープを切断する際に、該樹脂テープにおける90°未満の角度として切断する2つの領域の切断面と樹脂テープの基板貼付面とのなす角度を、2つの領域以外の領域の切断面と樹脂テープの基板貼付面とのなす角度よりも大きくすることを特徴とする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

請求項5に記載の発明は、回路基板上に樹脂テープを貼り付けるテープ貼付装置において、前記樹脂テープを供給するテープ供給部と、前記回路基板を保持する保持部と、前記樹脂テープを該樹脂テープにおける前記電子部品の隣接する2つの角に対応する角部分の角度が90°未満の角度になるように切断するカッタと、切断した樹脂テープを前記回路基板に押圧する押圧部とを備えたことを特徴とする。

請求項6に記載の発明は、請求項5記載のテープ貼付装置において、押圧部により、切断後の樹脂テープにおける90°未満の角度の2つの領域における加圧力を、前記2つの領域以外の領域における加圧力よりも大きくすることを特徴とする。